

证券代码：688809

证券简称：强一股份

公告编号：2026-002

强一半导体（苏州）股份有限公司 2025 年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

(1) 经财务部门初步测算，预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 36,800.00 万元到 39,900.00 万元，与上年同期（招股书数据）相比将增加 13,490.30 万元到 16,590.30 万元，同比增加 57.87% 到 71.17%。

(2) 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 36,500.00 万元到 39,500.00 万元，与上年同期（招股书数据）相比，将增加 13,795.08 万元到 16,795.08 万元，同比增加 60.76% 到 73.97%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一) 利润总额：25,756.39 万元。归属于母公司所有者的净利润：23,309.70 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：22,704.92 万元。

(二) 每股收益：2.40 元。

三、本期业绩变化的主要原因

2025 年度，公司净利润预计实现高速增长，核心系精准把握半导体行业景气周期与国产替代机遇，技术壁垒筑牢竞争优势，订单与盈利同步攀升。

全球人工智能算力需求的爆发式增长，叠加半导体产业链升级以及自主可控的强劲趋势，共同驱动高端芯片在测试环节的需求快速增长与技术迭代。公司作为国内探针卡龙头供应商，产品精准匹配下游市场对更高性能、更先进工艺的迫切需求，来自通信网络、AI 算力等芯片领域头部客户的订单强劲增长，推动产能利用率维持高位。

产品端，成熟 2D MEMS 探针卡持续提升渗透率，凭高密度、高精度优势抢占高端逻辑芯片测试市场，成为业绩增长核心引擎，优化盈利结构。2.5D MEMS 探针卡通过存储领域头部客户验证并小批量出货，贡献新增收入。薄膜探针卡依托技术稀缺性，积极布局海外市场，收入稳步增长，形成多产品协同效应。

此外，受益于国产替代加速，公司打破海外垄断，产能高效调配保障订单交付，规模效应持续释放，叠加聚焦高端化、精准化发展，高毛利产品收入占比提升，多重因素共同推动整体盈利水平大幅增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日